

ClayTec HFA dünn

Art. 09.009 D = 8 mm

- **Ökologische Holzfaserausbauplatte (HFA)**
- **Lehmputz-Trägerlage im Holzbau**
- **Dünn und preisgünstig**



Dünne Holzfaserausbauplatte (HFA) als Putzträger auf Holz- und Holzwerkstoffen. Die Platten können geschraubt oder geklammert werden. So entsteht auf Holz sehr einfach ein sicherer Untergrund für die Armierungslage aus Lehmklebe- und Armiermörtel und das nachfolgende Lehm-Finish. Ergänzend zu diesem Produktblatt gilt der **ClayTec Leitfaden ökologische Trockenbauwände im System**.

 **ClayTec**[®]

DEUTSCHLAND
© ClayTec GmbH & Co. KG
Nettetalter Straße 113-117
D-41751 Viersen-Boisheim
+49 (0)2153 918-0
service@claytec.com
claytec.de

ÖSTERREICH
© ClayTec Lehmbaumstoffe GmbH
Stranach 6
A-9842 Mörttschach
+43 (0) 676 430 45 94
service@claytec.com
claytec.at

Ausgabe 2025/2
Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Aktuelle Version
unter claytec.de

ClayTec HFA dünn

Art. 09.009 D = 8 mm

Anwendungsgebiet Holzfaserausbauplatte (HFA) als Putzträger im Holzbau für ClayTec Lehmputze im Innenbereich. Auf Flächen der Wassereinwirkungsklasse WO-I nach DIN 18534-1, z. B. in Bädern (außer Duschbereiche) und häuslichen Küchen.

Baustoffwerte Druckfestigkeit ≥ 100 kPa, Rohdichte 230 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit-Wert 0,05 W/mK, μ 5. Wärmespeicherung: Cp 2,1 kJ/kgK, 3,9 kJ/m²K. Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E

Maße D = 8 mm. L= 1.200 m, B = 600 m. Fläche pro Platte = 0,72 m².

Lieferform 276 Platten/EW-Pal.

Lagerung Im Lager liegend auf Paletten, trocken. Die Lagerung ist unbegrenzt möglich. Beim Transport und Lagerung auf der Baustelle vor Nässe schützen. Auf der Baustelle liegend und eben lagern auf trockenen Paletten oder Hölzern. Kanten vor Beschädigungen schützen.

Luftfeuchtigkeit Feuchtebeanspruchungen aus nass eingebauten Putzen und Estrichen nicht zulässig. Allgemein darf die relative Luftfeuchte bei Lagerung und nach dem Einbau 70 % nicht übersteigen.

Materialbedarf Bei der Ermittlung des Materialbedarfs Reserve von ca. 10 % für Verschnitt etc. berücksichtigen.

Untergrund Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, trocken, sauber (Holzwerkstoffplatten staubfrei), frei von Salzbelastung, ausreichend rau und saugfähig sein. Fehlstellen grob ausbessern. Sandene Untergründe ggf. mit ClayTec Tiefengrund und Festiger fixieren.

Verarbeitung Die Platten werden mit der Stichsäge, der Kreissäge oder mit dem Cuttermesser geschnitten.

Die unterste Plattereihe wird mit etwas Abstand („Luft“) zum Boden eingebaut.

Auf Holz oder Holzwerkstoffen flächige Befestigung mit Schrauben (ClayTec Lehmbauplattenschrauben im Abstand von 200 mm), in der Regel aber Klammerbefestigung mit Klammern 25 mm, z. B. haubold Klammern Serie KG 700 (ETA-Zulassung), Abstand der Klammern ca. 150 mm, Randabstand 25 mm (von Mitte Klammer). Klammern sind Oberflächen-bündig einzutreiben, sie dürfen nicht versenkt werden. Holzwerkstoffplatten sollen nicht von den Schrauben oder Klammern durchstoßen werden.

Kreuzfugen und die Fortführung von Wandöffnungsbegrenzungen durch horizontale oder vertikale Fugen sind unzulässig. Die Verarbeitung der Platten erfolgt mit um mind. 20 cm, besser 30 cm versetzten vertikalen Stößen.

Weiterbehandlung Für die Fugen- und Beschichtungsarbeiten darf die Raumtemperatur etwa +10° C nicht unterschreiten. Grundsätzlich ist der Feuchteintrag durch den Verputz ist so niedrig wie möglich zu halten. Die wandumlaufende Plattenfuge wird mit ClayTec Lehm-Fugenfüller geschlossen.

Platten sorgfältig entstauben. Spalte ≥ 1 mm Breite mit ClayTec Lehmklebe- und Armiermörtel oder Lehm-Oberputz fein O6 in voller Querschnitt-Tiefe ausspachteln und trocknen lassen.

Dünnlagenbeschichtung: Schraublöcher und Vertiefungen vorab schließen. Nach Trocknung Flächen 3 mm dick mit Lehmklebe- und Armiermörtel überziehen (auch mit der Putzmaschine, Mörtelruhezeiten sind dann nicht notwendig). In die noch nasse Oberfläche wird Glasgewebe flächig eingearbeitet. Nach Trocknung YOSIMA Lehm-Designputz fachgerecht mit geriebener Oberfläche ausführen (geglättete Ausführung nicht möglich). Alternativ Armierlage fertig für den Anstrich ausführen (frisch-in-frisch Überzug D = 1 mm) oder nach Trocknung mit Lehm-Oberputz fein O6, D = 3 mm überziehen, Anstrich mit dem ClayFix Lehm-Astrichsystem oder ClayTec Lehmfarbe (verarbeitungsfertig).

Dicklagenbeschichtung: Flächen mit der Grundierung DIE ROTE vorbehandeln. Lehm-Unterputz mit Stroh, Lehmputz Mineral 20 oder SanReMo in einer Lagen-dicke max. 8 mm auf Wandflächen und max. 5 mm auf Decken- oder Dachschrägenflächen auftragen. In die noch nasse Oberfläche Glasgewebe flächig einarbeiten. Trocknen lassen. Gesamtputzaufbaudicke Wand max. 15 mm, Decken- oder Dachschrägen max. 10 mm, jeweils mind. zweilagig).

Wandflächenheizung: Vorbereiten der Flächen mit der Grundierung DIE ROTE oder per Zahnpachtelung. Trocknen lassen. Vorspritz bis max. 8 mm mit einem der o.g. Lehmputzmörtel. Nach Trocknung Auffüttern bis Rohrscheitel Wandheizung. Trocknung des gesamten Unterputzes mit Heizungsunterstützung möglich. Weiteres siehe ClayTec Arbeitsblatt Lehmputze.

Auf Schnittflächen kann in selten Fällen Lignin durchschlagen, die Bereiche können mit handelsüblichen Mitteln gesperrt werden.

Ergänzend zu diesem Produktblatt gilt der **ClayTec Leitfaden ökologische Trockenbauwände im System**.

Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 2025/2.